ベトナム第三工場 ロードマップ

Contents		Technology Roadmap（Unit: μm）		
		FY 2026	FY 2027	FY 2028
L/S Line Width/Space	Tenting（Cu thickness 13μm）	25/30	←	←
	MSAP（Cu thickness 13μm）	20/20	15/20	15/15
WB Pad Width/Space	Tenting（Cu thickness 13μm）	70	←	←
	MSAP（Cu thickness 13μm）	55	50	←
Laser Via Pitch/via Size/Pad Diameter（Annular Ring）		160/60/120（30）	140/50/100（25）	120/40/80（20）
Mechanical Via Size/Pad Diameter（Annular Ring）		100/200（50）	80/180（50）	←
X-via	Via diameter Top/Bot	75/50	60/40	←
	Core thickness	60-200	50-100	40-100
	Specification	Filled/Dimple	←	←
Core Thickness		40	←	←
PP Thickness		20	15	←
Copper thickness		13	10	←
Coreless	Availability	○	←	←
Solder Resist	Thickness	13	←	10（DF-SR）
	SRO Size	100	80	←
	SRR	20	15	←
	Flatness	5	←	←
	Method	Ink/DFSR	←	←
Surface Finish	Au Plating	Soft/Hard Gold, ENEPIG	←	←
	OSP	Shikoku: F2LX（PK）	←	←
Front and back misalignment		25	20	←
Total Thickness		Cored（2L）120 Coreless（3L）106 Coreless（4L）121	Cored（2L）100 Coreless（3L）88 Coreless（4L）121 Coreless（5L）146 Coreless（6L）172	Cored（2L）90 Coreless（3L）82 Coreless（4L）108 Coreless（5L）134 Coreless（6L）160
Strip Size（Small Strip）		Min 25mm	←	←
Process		STD/EB/EBS	←	←

MEIKO